中華民國生物醫學工程學會　函

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 108. 04. 09 文
檔號: 108208

會　址：10617 台北市羅斯福路四段 1 號
展書樓 608 室
電　話：02-23678803
聯絡人：鄒雲蝶小姐
電子信箱：tsbme2017@gmail.com

受文者：各醫院及各大專院校

發文日期：中華民國 108 年 4 月 3 日
發文字號：(108) 醫工字第 010 號
速別：普通件
密等及解密條件或保存期限：普通
附件：如文

主旨：本學會將於民國108年8月17至8月19日舉辦「2019生物醫學工程科技研討會暨科技部醫學工程學門成果發表會」，敬邀 貴單位人員撥冗報名參加並惠予公假，請 查照。

說明：

(一) 活動時間：108 年 8 月 17 日至 8 月 19 日

(二) 活動地點：國立台灣大學

(三) 本學會將授予此活動主要教育學分 20 學分（限本學會會員）。

(四) 研討會報名網址：
http://www.wacbe2019.org/Registration.php

(五) 可於研討會現場報到處繳納 109 年度常年會費 1,200 元整。

(六) 僅欲參與其中一日活動者，可選擇註冊 One-Day Registration，早鳥優惠價2,000元（不含晚宴，若欲參加晚宴者，須另購晚宴票2,000元），截至5月1日為止。

正本：各醫院及各大專院校

副本：中華民國生物醫學工程學會　　理事長 王兆麟